

真空脱ガス炉 SBF-H500TB



真空脱ガス炉SBF-H500TBは、半導体部品、電極部品、ポリマー材、SUS部品等を減圧下において加熱し、脱ガス処理を行うことを目的とした装置です。メインポンプにターボ分子ポンプを採用。クリーンな減圧下において加熱作業が可能です。本装置のメインバルブはゲートバルブを採用しておりますので、通常のアングルバルブに比べて、ターボ分子ポンプの排気速度を最大限発揮出来ます。又、各ヒーターゾーン6面をPID方式にて制御しておりますので、温度指示値の信頼性も高くなるよう製作しております。

真空脱ガス炉 SBF-H500TB 仕様

○到達圧力	1.5×10 ⁻⁵ Pa以下※常温・ワーク未挿入・脱ガス完了時	
○排気速度	9.9×10 ⁻⁵ Pa以下まで排気開始から20分以内※常温・ワーク未挿入・脱ガス完了時	
○装置漏洩量	×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /sec台(Heリークデテクター試験による)	
○気体放出量	×10 ⁻⁶ Pa・m ³ /sec台(24hrビルドアップ試験による)	
○処理室径	650mmW×650mmD×500mmH 材質:SUS304	
○表面処理	電解研磨処理	
○加熱方法	シースヒーター	
○有効加熱領域	450mmW×450mmD×300mmH	
○最高温度	500℃(熱板を測温)	
○常用温度	RT~450℃(熱板を測温)	
○温度分布	450℃±5℃(有効加熱領域帯5点測温)※定温運転中	
○制御方法	6ゾーン(上・右・下・左・前・後)を 6サイリスタ(上・右・下・左・前・後)にて各々制御 PID式デジタルプログラムコントローラ6式 (マスター・スレーブ通信)	
○真空排気系	ドライポンプ:920L/min ターボ分子ポンプ:1030L/sec	
○真空計	コールドカソードピラニ真空計	
○操作方法	加熱系(自動/手動)・排気系(自動/手動)	
○制御系	タッチパネル(10インチ)/シーケンサー/ハイブリッド記録計(5.7インチ)	
○ユーティリティ	動力	φ3×AC200V×15kW 50/60Hz 1系統
	計装エア	圧力:0.5MPa~0.6MPaG 1系統
	冷却水	圧力:0.1~0.3MPaG 流量:20L/min以上 1系統
		差圧:0.1MPaG 水温:25℃以下
		冷却能力:6.0kW以上 水質:日本冷凍空調工業会の水質管理基準
	乾燥窒素	圧力:0.05MPaG~0.2MPaG 1系統
○設置スペース	2500mmW×2500mmD×2500mmH以上	
○オプション	計装エア用コンプレッサー/冷却水循環装置/クリーンブース/四重極型質量分析計	

